

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-029

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于公司新增银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授信基本情况概述

为有效降低公司财务费用，提升盈利能力，公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 8,000.00 万元综合授信额度，具体融资金额及利率将根据公司实际资金需求，以管理层与银行签署的融资协议为准。

二、 决策程序

公司于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并表决通过了《关于公司新增银行综合授信的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

三、 申请综合授信的必要性以及对公司的影响

本次新增银行授信额度有利于公司通过对不同银行之间的产品、利率进行比较，选择适合公司的融资产品类型，从而有效降低财务费用，提升公司盈利能力，改善公司财务状况。上述授信将对公司持续发展产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

四、 备查文件目录

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2023年2月22日